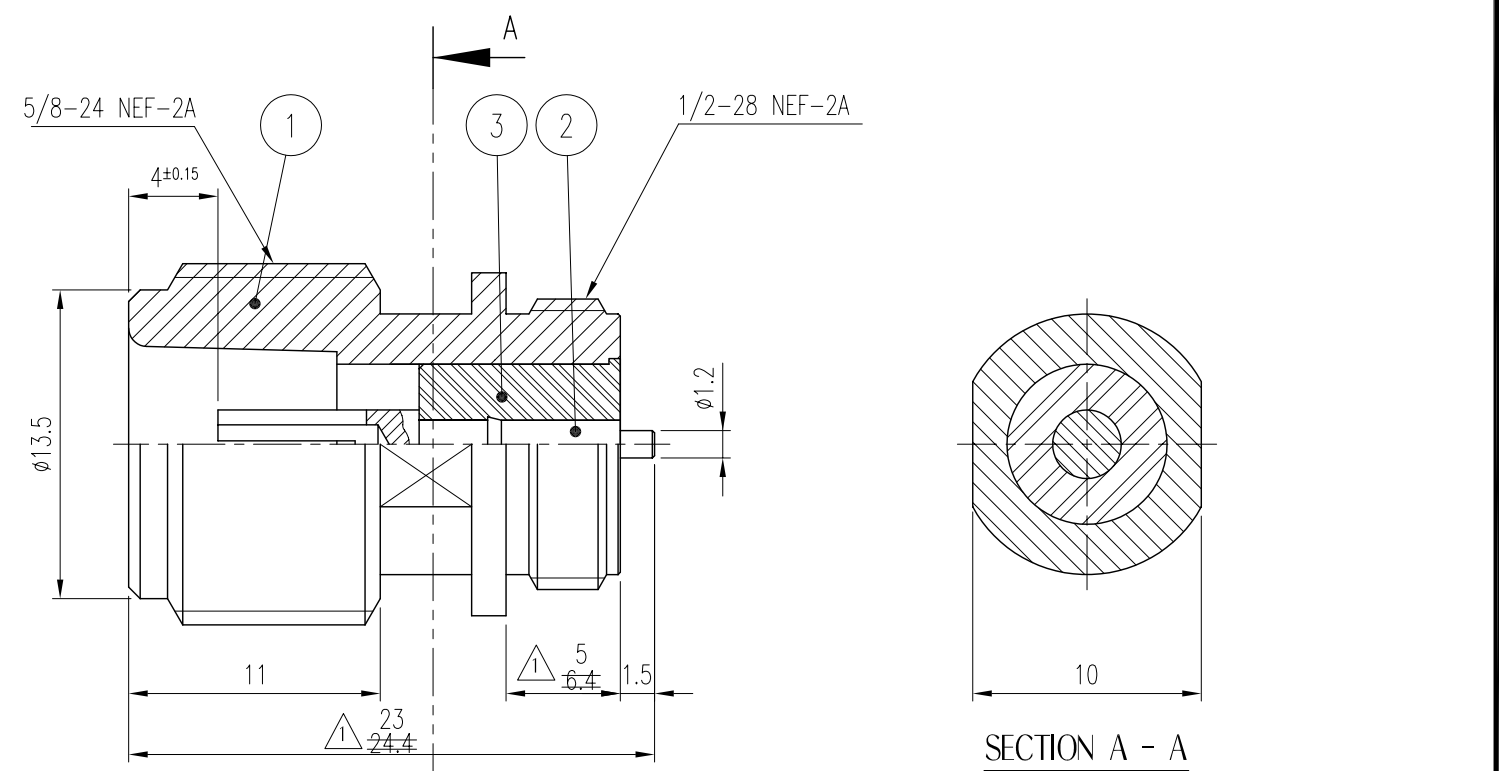


ST	기공	수 정 내 용									
		부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
ST(기초)		1	[첨변No.]연구2005-213 컴퓨터트럼 요구에 의한 같이변경 및 도금두께 변경	김인철	최종락	2005.	9.	6.			
ST(개선)											



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00688-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate (외부7μm)	DCT00722-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate (외부6μm)	DBD00957-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2005. 6. 2.				
소수 각도 분수	승인					
재질	검도	도명				
열처리	제도	N50-J-BR VER.1				
보호파막처리	작성부서	연 구 소		도번		
	적도 NS	단위 mm	중량	A4 CN00793-7/1		
				K345-524-006		

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017